

# 入札説明書

【一般競争入札（総合評価落札方式 - ランプサム型）】

業務名称：インド国日印半導体サプライチェーン情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式 - ランプサム型））

調達管理番号：23a00977

【内容構成】

第1章 入札の手続き

第2章 特記仕様書

第3章 技術提案書作成要領

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下、JICA という）」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。

本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。

調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意ください。

2024年3月13日

独立行政法人国際協力機構

調達・派遣業務部

# 第1章 入札の手続き

## 1. 公告

公告日 2024年3月13日

## 2. 契約担当役

理事 井倉 義伸

## 3. 競争に付する事項

(1) 業務名称：インド国日印半導体サプライチェーン情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式 -ランプサム型））

(2) 業務内容：「第2章 特記仕様書」のとおり

(3) 適用される契約約款：

「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、契約書では消費税を加算します。（全費目課税）<sup>1</sup>

なお、本邦招へいに係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結しますので本体契約には含めません。これにより入札書にも計上不要になります。本邦招へい業務は、9,182,000円（税抜）程度を予定しています。

(4) 契約期間（予定）：2024年5月から2025年3月

先方政府側の都合等により、本入札説明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、必要な調整を行います。

(5) ランプサム（一括確定額請負）型契約

本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム（一括確定額請負）型にて行います。

## 4. 担当部署・日程等

(1) 選定手続き窓口

---

<sup>1</sup> 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。

調達・派遣業務部 契約第一課

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp

担当者メールアドレス：Matsushita.Yuichi@jica.go.jp

(2) 事業実施担当部

南アジア部 南アジア第一課

(3) 日程

本案件の日程は以下の通りです。

No.	項目	期限日時
1	配付依頼受付期限	2024年3月19日 12時
2	入札説明書に対する質問	2024年3月19日 12時
3	質問への回答	2024年3月25日
4	技術提案書の提出用フォルダ作成依頼	技術提案書の提出期限日の 4営業日前から1営業日前の正午まで
5	入札書（電子入札システムへ送信）、別見積書・技術提案書の提出日	2024年3月29日 12時
6	技術提案書の審査結果の連絡	入札執行の日時の2営業日前まで
7	入札執行の日時（入札会）	2024年4月11日 10時
8	技術評価説明の申込日（落札者を除く）	入札会の日日の翌日から起算して7営業日以内 （申込先： <a href="https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE">https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE</a> ） ※2023年7月公示から変更となりました。

## 5. 競争参加資格

(1) 各種資格の確認

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン（2023年10月）」を参照してください。

(URL: <https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html>)

- 1) 消極的資格制限
- 2) 積極的資格要件
- 3) 競争参加資格要件の確認

## (2) 利益相反の排除

具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。  
特定の排除者はありません。

## (3) 共同企業体の結成の可否

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（1）の2）に規定する競争参加資格要件を求めません（契約締結までに、法人登記等を確認することがあります）。

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作成し、技術提案書に添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社印の押印が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共同企業体結成の合意状況について、記載してください

## 6. 資料の配付依頼

資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・技術提案書・見積書等の電子提出方法（2023年3月24日版）」に示される手順に則り依頼ください（依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「4.（3）日程」参照）。

（URL：<https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1>）

提供資料：

- ・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
- ・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022年4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」

「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022年4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」については、技術提案書提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。

## 7. 入札説明書に対する質問

### (1) 質問提出期限

- 1) 提出期限：上記4.(3) 日程参照
- 2) 提出先：上記4.(1) 選定手続き窓口宛、  
CC: 担当メールアドレス
- 3) 提出方法：電子メール
  - ① 件名：「【質問】 調達管理番号\_案件名」
  - ② 添付データ：「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)

注1) 質問は「質問書フォーマット」の様式に記入し電子メールに添付して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性があります。JICA 指定様式は下記(2)の URL の「公示共通資料」を参照してください。

注2) 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。

### (2) 質問への回答

- 1) 上記4.(3) 日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。  
(URL: <https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1>)
- 2) 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものととして取り扱います。

### (3) 説明書の変更

競争参加予定者からの質問を受けて、又は JICA の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前までに JICA ホームページ上に行います。

(URL: <https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1>)

変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。

## 8. 入札書・技術提案書の提出

(1) 提出期限：上記4.(3) 日程参照

(2) 提出方法：

具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・技術提案書・見積書等の電子提出方法(2023年3月24日版)」をご参照ください

(URL: <https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1>)

#### 1) 技術提案書

- ① 技術提案書の提出方法は、電子データ（PDF）での提出とします。
- ② 上記4.（3）日程にある期限日時までに、技術提案書提出用フォルダ作成依頼メールを e-koji@jica.go.jp へ送付願います。
- ③ 依頼メール件名：「提出用フォルダ作成依頼\_（調達管理番号）\_（法人名）」
- ④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合は技術提案書の提出ができなくなりますので、ご注意ください。
- ⑤ 技術提案書はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。

#### 2) 入札書（入札価格）

- ① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額（消費税は除きます。）を、上記4.（3）日程の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
- ② 上記①による競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。

#### 3) 別見積

別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記4.（3）日程を参照し提出期限日時までに別途メールで e-koji@jica.go.jp へ送付ください。なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。

### (3) 提出先

#### 1) 技術提案書

「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」

#### 2) 見積書（別見積書）

- ① 宛先：e-koji@jica.go.jp
- ② 件名：（調達管理番号）\_（法人名）\_見積書  
[例：22a00123\_〇〇株式会社\_見積書]
- ③ 本文：特段の指定なし
- ④ 添付ファイル：「22a00123\_〇〇株式会社\_見積書」

- ⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。

(4) 提出書類

- 1) 技術提案書・別見積書

(5) 電子入札システム導入にかかる留意事項

- 1) 作業の詳細については、電子入札システムポータルサイトをご確認ください。

(URL:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

- 2) 電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。

## 9. 技術提案書の審査結果の連絡

技術提案書は、JICAにおいて技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、入札会の2営業日前までに、電子メールにて結果を連絡します。期日までに結果が通知されない場合は、上記4. 選定手続き窓口にお問い合わせ下さい。入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書（電子データ）は、JICAにて責任をもって削除します。

## 10. 入札書

- (1) 入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価（円）（消費税抜き）をもって行います。電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。また、電子入札システムにて自動的に消費税10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
- (2) 競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
- (3) 競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
- (4) 入札保証金は免除します。
- (5) 入札（書）の無効

次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。

- 1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
- 2) 入札書の提出期限後に到着した入札
- 3) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
- 4) 明らかに連合によると認められる入札
- 5) 同一競争参加者による複数の入札
- 6) 条件が付されている入札

- 7) 定額計上を入札金額に含める指示がある場合、入札金額内訳書にて異なる金額が計上された入札
- 8) その他入札に関する条件に違反した入札

## 1 1. 入札執行の日時、手順等

(1) 日時：上記4.(3) 日程参照

(2) 入札会の手順

- 1) 開札方法：本案件では電子入札システムにて開札を行います。
- 2) 再入札：全ての入札価格が予定価格を超えた場合（以下「不落」という。）には、再入札を実施します。詳細は下記1 1.(3)のとおりです。
- 3) 入札途中での辞退：

「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、再入札の日時まで電子入札システムから辞退届を必ず提出（送信）してください。<sup>2</sup>

(3) 再入札の実施

すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合（不落）は、再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は2回まで実施します。

機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実施通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法により電子入札システムへ再入札価格を送信してください。

(4) 入札者の失格

入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。

(5) 入札会の終了

3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、（不落）随意契約の交渉をお願いする場合があります。

## 1 2. 落札者の決定方法

(1) 評価方式と配点

技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格

---

<sup>2</sup> この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。



評価点を合算した総合評価点を 100 点満点とし、配点を技術評価点 70 点、価格評価点 30 点とします。

## (2) 技術評価の方法

「第 3 章 技術提案書作成要領」の別紙「技術提案書評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン（2023 年 10 月）」より以下を参照してください。

- ① 別添資料 1 「プロポーザル評価の基準」
- ② 別添資料 2 「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」

## (3) 価格評価

価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます（小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出）。具体的には以下の算定式により、計算します。

- ① (価格評価点) = 最低見積価格 = 100 点
- ② (価格評価点) = 最低見積価格 / (それ以外の者の価格) × 100 点

ただし、ダンピング対策として、競争参加者が予定価格の 80%未満の見積額を提案した場合は、予定価格 80%を見積額とみなして価格点を算出します。

なお、予定価格の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。

最も安価な見積額：価格評価点 = 100 点

それ以外の見積額 (N)：価格評価点 = (予定価格 × 0.8) / N × 100 点

\* 最も安価ではない見積額でも予定価格の 80%未満の場合は、予定価格の 80%を N として計算します。

予定価格を上回る入札金額（応札額）については、失格とします。

## (4) 総合評価の方法

技術評価点（加点分を含む）と価格評価点 70 : 30 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。

(総合評価点) = (技術評価点) × 0.7 + (価格評価点) × 0.3

#### (5) 落札者の決定方法

以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。

- 1) 技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
- 2) 入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
- 3) 当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと

### 1 3. 契約書作成及び締結

- (1) 落札者から、入札金額内訳書を提出いただきます。
- (2) 速やかに契約書を作成し締結します。
- (3) 契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」については、入札金額内訳書に基づき、設定します。

### 1 4. フィードバックのお願いについて

JICAでは、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。2023年11月から2024年1月に公示した案件を対象として試行的に実施していましたが、4月末まで期間を延長します。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用Formsをご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。

以上

## 第2章 特記仕様書

本特記仕様書に記述されている「脚注」及び別紙の「技術提案書にて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者が技術提案書を作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。また、契約締結に際しては、技術提案書の内容を適切に反映するため、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。

### 第1条 調査の背景・経緯

インドでは人口増加、年率6%を超える急速な経済成長、IT産業及びスマートフォン製造等その他デジタル産業の発展に伴い、半導体及び電子部品の需要増加が見込まれており、半導体の国内消費額は2020年時点で約1.1兆ルピー（約132億USドル）だが、2026年までに800億USドルを超えると想定されている（インド電子情報技術省、2022年）。他方、現状では国内に商業用の製造拠点を有さず、米国・中国・韓国・台湾等からの輸入に依存している。また、各国政府も経済安全保障等の観点から、半導体の生産基盤の国内誘致及び関係国間のサプライチェーン連携を目的に巨額の補助金・投資誘致策を含む産業政策を展開しており、インドの産業振興においても半導体サプライチェーンへの参画が急務となっている。

こうした状況を受けて、同国政府は「自立したインド政策」を掲げ、各産業における輸入依存の低減、自国の生産・輸出拠点としての地位強化を志向する中で、特に半導体を始めとする電子産業の強化を最重要産業政策と位置付けている。具体的には、外資誘致・生産拠点設置を通じた半導体及び電子部品の国内生産強化を目的に、2.3兆ルピー（約280億USドル）程度の予算措置を講じ、半導体のグローバル・ハブとなることを目指している。また「生産連動型補助金（PLI）」、「電子部品・半導体製造促進政策（SPECs）」、「通信機器製造クラスター計画（EMC2.0）」等のインセンティブ・スキームを導入し、2021年には7,600億ルピー（約1.3兆円）規模の予算を投じ「半導体・ディスプレイ製造エコシステム開発プログラム」を立上げる等、インド国内での半導体製造基盤の構築等に取り組んでいる。またインド人が世界の半導体設計人材の2割を占める等、同国には設計人材は多く存在する一方で、半導体製造に係るノウハウ・人材は有しておらず、加えて半導体製造に必要な製造装置・部素材についても、その多くを国外から調達する必要がある。

日本政府も半導体・デジタル産業を「国家事業」と位置づけ、2021年に「半導体・デジタル産業戦略」を策定した（その後2023年6月に改定）。同戦略において半導体については（1）半導体生産基盤の強化、（2）日米連携強化による次世代半導体技術基盤整備、（3）グローバル連携による技術基盤整備に取り組むこととしており（2023年、経済産業省）、その実現のため関係国との国際連携や人材育成に取り組む方針となっている。日本は半導体部素材や、製造装置に強みがある一方で、今後国内の半導体産業を強化するにあたり人材確保の重要性が高まっている。

日印両政府は半導体サプライチェーン強化を最重要産業政策として位置づけており、2023年7月に「日印半導体サプライチェーンパートナーシップ」が両国大臣間で締結され、「日印半導体サプライチェーン政策対話」が設置された。同パートナーシップの下、相互の強み

に基づく両国の半導体サプライチェーンの強靱化に向けた協力の強化、半導体関連企業の投資・技術面での連携強化の促進、人材・研究開発分野での協力の模索等が今後両国政府間で進められていく。加えて、2024年1月にグジャラート州で開催されたモディ首相出席の国際会議「ヴァイブラント・グジャラート」において、日本政府より、同パートナーシップに基づき JICA を含むあらゆる手段を活用した日印半導体協力を進め、両国のサプライチェーン強化更にはインドの産業高度化に貢献していく方針が表明された。また、同会議では半導体製造拠点化を志向するグジャラート州政府及び印半導体関連企業と日本政府及び政府系機関（JICA 含）・半導体関連日本企業との間で、産官フォーラムが実施され、日印半導体協力に関して活発に議論が交わされる等、同分野での日印協力の機運が産官両面で高まっている。

## 第2条 調査の目的と範囲

### （1）調査の目的

本調査は人材育成・連携、産学連携・共同研究促進、製造装置・部材を含む対インド投資促進、高度な基礎インフラ整備等の分野に焦点を当て、主に新規円借款事業を想定した新規支援方針案についての検討、及び既往円借款事業への半導体関連コンポーネントの組み込み、その他海外投融資等を含めた新たな協力の可能性の検討を進めるため、その前提となる情報収集・分析を実施するものである。なお、日印間半導体サプライチェーン協力の取り組みは、関係国間の重要技術分野の連携に貢献し、特定国へのサプライチェーン依存の低減、ひいては我が国の経済安全保障にも貢献することから、我が国の「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想や QUAD 等の外交的取組にも資する。

### （2）調査の範囲

受注者は、上記「第2条（1）調査の目的」を達成するために、「第3条 調査実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第4条 調査の内容」に示す事項の調査を実施し、「第5条 報告書等」に示す報告書等を発注者に提出するものである。

## 第3条 調査実施方針及び留意事項

### （1）調査対象サイト

インドにおける半導体関連産業振興の拠点となりうる地域・機関（以下参照）、及び日印半導体サプライチェーン協力の日本側の担い手となる機関等を主な調査対象とする。

- ・ グジャラート州
- ・ カルナタカ州
- ・ テランガナ州
- ・ タミル・ナド州
- ・ ウッタール・プラデシュ州
- ・ アッサム州

### （2）調査対象機関

- ・ 印政府半導体関連機関（電子情報技術省、Semiconductor Laboratory、各州政府機関等）
- ・ 印半導体研究機関（インド工科大学等）

- ・ 日印及び関係国半導体関連企業
- ・ 日本地方自治体（北海道、熊本県等）

### （3）調査方針

半導体関連分野での日印協力の重要性が目下急速に高まっている一方、同分野での日印協力の実績は限定的である。また同分野においては投資促進・人材育成・インフラ等 JICA が強みとする事業での貢献余地がある一方、JICA として同分野での協力に取り組んだ例はない。これらを踏まえ、以下方針を念頭に調査を実施する。

#### ① 新規支援方針案検討のための情報収集

JICA がノウハウ・実績を持つ、人材協力、対インド投資促進、高度な基礎インフラの事業分野に特に焦点を当て、日印両国の半導体関連アクター連携に向けた JICA としての取組を検討する。具体的には、主に政策借款やセクターローン等の新規円借款事業、その他海外投融資等も想定した新規支援方針案を検討するため、前提条件等の必要な情報を取りまとめ、提案する。

#### ② 既往事業への半導体関連コンポーネントの組み込み

インド工科大学ハイデラバード校支援事業における半導体関連日印産学研究、経営幹部育成を基盤とした日印共創ビジネス交流促進プラットフォーム構築プロジェクト（SGBBE）における日印半導体産業界交流、タミル・ナド州投資促進プログラム、グジャラート州投資促進プログラムにおけるビジネス環境改善等の成果をベースとした半導体協力等、既往事業における半導体関連コンポーネント（印人材育成、日印人材交流、高度な基礎インフラ整備等）の組み込みの可能性についても検討する。

#### ③ JICA に求められる役割の明確化及び関係アクターとの連携

我が国半導体産業振興及び日印半導体サプライチェーンパートナーシップの下で、日本政府や JBIC、JETRO、NEDO 等様々な政府系機関が取組を進める中で、JICA を含む関係機関のあるべき役割分担を明確化する。また、各種機関と連携した日印半導体関連協力の方向性についても検討する。

#### ④ 日本側アクターの特定

日印間での協力実績が乏しい半導体関連分野において、両国に利益のある協力事業を具体化するためには、同分野での技術・知見を有する日本の企業・研究機関によるインドへの投資・関与が重要になる。本調査においては、印の半導体情勢の分析に留まらず、日印半導体関連協力のプレイヤーとなり得る日本側アクターの特定及びニーズや印側アクターとのマッチング可能性の分析を行い、可能であれば日印間のキックオフを実施する。これを通じて、日印アクター間の協力開始・強化に際して JICA を含む関係機関が貢献しうる方向性を検討する。

#### ⑤ 日本政府半導体政策・対印政策との連携

日本政府は、経済安全保障の強化やデジタル産業の基盤強化を実現すべく、半導体分野を最重要産業の一つに位置付けており、「半導体・デジタル産業戦略」の下で、大規模な予算措置含む様々な産業振興策を推進している。その一環として、日本政府は、米国や欧州に続き、インドと大臣級の「日印半導体サプライチェーンパートナーシップ」を 2023 年 7 月に立ち上げている。また、日印首脳間による 5 年で 5 兆円の対印投融資目標のほか、

「日印産業競争力パートナーシップ」や「日印デジタルパートナーシップ」等の枠組みの下で、産業・デジタル分野の協力も進められている。これら日本政府の方針に準じた協力の方向性を検討する。

## ⑥ 関係国連携

半導体サプライチェーンが国境を越えて展開されるなかで、日印両国は、米欧等の関係国・地域を相手とする技術連携や投資促進を通じた半導体産業振興に取り組んでいる。日印半導体関連協力の強化に際しては両国企業に加えて関係国・地域の企業もプレイヤーとなり得るため、日印半導体関連協力に関連する関係国・地域の動向について分析する。

## ⑦ 我が国地域振興

我が国の半導体産業振興に際して、半導体産業が集積する熊本等九州をはじめ、各地域が産学官連携を通じた地域単位の取組を進めている。特に人材面で日印半導体関連協力が我が国地域振興に資する可能性があるため、本調査では地域振興という観点での協力の可能性についても検討する。

## 第4条 調査の内容

### (1) 調査の内容

本調査は、「日印半導体サプライチェーンパートナーシップ」に準じ、特に、半導体人材協力、産学連携促進、対インド投資促進、高度な基礎インフラの分野に焦点を当て、対印協力の前提となる日印双方の政策・アクター・ニーズ等の基礎情報収集や、当該分野の日印カウンターパートの特定及び連携促進を行う。これらを通じて、主に既往円借款事業に対する半導体関連コンポーネントの組み込み可能性や既存成果をベースとした新たな協力の方向性や、新規円借款、その他海外投融資等を活用した新規支援方針案を検討するため、その前提となる情報収集・分析を実施するもの。また、関係国・地域連携・我が国地域振興への貢献可能性についても分析するもの。

### (2) 調査項目

#### ① 印半導体政策レビュー

- ・ 印政府及び各州政府（グジャラート、カルナタカ、テランガナ、タミル・ナド、アッサム、ウツタル・プラデシュ等）による半導体産業振興政策の分析・整理
- ・ インド国内の将来需要予測（国産化の政策動向を踏まえ）
- ・ 本調査で焦点を当てる州・地域の特定
- ・ インドにおける関係国の活動状況分析（米・欧・台等）
- ・ 関係省庁・機関等のステークホルダー特定、関係性整理
- ・ インド政府、他援助機関、民間企業、シンクタンク等が実施した半導体サプライチェーンに関する既往調査報告書の分析・整理

#### ② 印における半導体関連プレイヤー分析

- ・ 印半導体サプライチェーンに関係する日印及び諸外国半導体関連企業の戦略・動向の分析・整理
- ・ 印半導体研究機関の分析・整理（インド工科大学等）

③ 人材・研究面での課題・機会分析

- ・ 印半導体人材（開発・設計、製造）に係る現状及び課題の分析
- ・ 半導体人材育成及び研究に関する印側のニーズの特定
- ・ 日本側の印半導体人材及び研究に関するニーズの特定
- ・ 日印半導体人材及び研究協力の可能性及びプレイヤーの分析（印国内、日本等国外研修・留学含む）
- ・ 印半導体研究施設を活用した日印協力の可能性及び当該協力を資する研究施設コンセプト・活用方法検討

④ インフラ面の課題・機会分析（研究施設・クリーンルーム等含む）

- ・ 半導体産業振興に資する印基礎インフラの現状及び課題の分析
- ・ 半導体に関連する印側インフラニーズ分析
- ・ 印側ニーズに貢献しうる日本側インフラ技術・経験の分析
- ・ 日印半導体インフラ協力の可能性及びプレイヤー・地域の分析

⑤ 日本企業の課題・機会分析

- ・ 半導体関連分野における日本企業の対印進出・投資・貿易等の方向性及び勝ち筋の検討
- ・ 印側が期待する日本企業の技術・製品・活動の分析
- ・ 日本企業が印に対して提供しうる技術・製品・活動の分析（製造装置・部素材等）
- ・ 半導体関連分野における日印ビジネス協力の可能性及びプレイヤーの分析

⑥ 我が国地域振興への貢献可能性分析

- ・ 日印半導体協力の我が国地域振興への裨益可能性の分析
- ・ 当該協力の可能性及びプレイヤー・候補地域の分析

⑦ 関係国・地域連携への貢献可能性分析

- ・ 日印半導体関連協力を資する第三国アクターの分析
- ・ 第三国アクターを関与させる日印半導体協力の可能性の分析

⑧ JICA としての協力方向性提案

- ・ 課題・機会分析を踏まえ、対印協力方針も考慮し、円借款をメインとしつつ海外投融資等事業も含めた協力事業形成可能性の提案（具体的地域・分野に絞り込んで）、および可能な範囲での関係機関との協議実施
- ・ 既往事業への半導体関連コンポーネント組み込み可能性の提案、および可能な範囲での関係機関との協議実施
- ・ JICA による日印半導体関連協力の取組ロードマップ提案、および可能な範囲での関係機関との協議実施

⑨ 日印関係者招へい

- ・ ⑧の具体化・立ち上げに資する印関係者の日本招へい、もしくは日本関係者の訪印（1週間程度、調査結果に応じて内容検討）

## 第5条 報告書等

調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、成果品はファイナル・レポートとする。

各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について了承を得るものとする。なお、下記部数は発注者へ提出する部数とし、その他現地での説明に必要な部数は別途受注者が準備するものとする。

### （1）調査報告書

#### 1) インセプション・レポート (IC/R)

提出時期：2024年6月28日

部数：電子データのみ（日本語・英語）

#### 2) インテリム・レポート (IT/R)

提出時期：2024年10月31日

部数：電子データのみ（日本語・英語）

#### 3) ドラフト・ファイナル・レポート (DF/R)（簡易製本）

提出時期：2025年1月10日

部数：和文2部、英語5部、CD-R2部（日本語1部、英語1部）

#### 4) ファイナル・レポート (F/R)（製本）

提出時期：2025年2月10日

部数：和文5部、英文7部、CD-R4部（日本語2部、英語2部）

注）報告書類の印刷、電子化（CD-R）については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。

### （2）その他の報告書類

#### 1) 業務計画書

記載事項：共通仕様書第6条に記載するとおり。

提出時期：契約開始後10営業日以内

部数：電子データのみ（日本語）

#### 2) その他説明資料

記載事項：関係機関に対する調査進捗報告。

提出時期：報告の都度、及びF/R提出時にまとめて提出。

部数：報告時は必要部数、F/R提出時はF/Rに添付もしくは別添とする。

#### 3) 面談録



記載事項：関係機関との面談を実施した際の議論の要旨。

提出時期：面談実施後、ワードファイル等でメールに添付し速やかに提出。

部数：F/R 提出時は F/R に添付もしくは別添とする。

### (3) 報告書の仕様

ドラフト・ファイナル・レポートについては簡易製本、ファイナル・レポートについては製本したものを提出すること。それ以外の報告書については原則として電子データのみを作成することとする。なお、各種報告書の作成に当たっては「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」の印刷仕様・電子仕様を参照すること。

### (4) 収集資料

調査時に収集した資料及びデータは分野別に整理してリストを付した上で提出すること。

### (5) 報告書作成にあたっての留意点

- 1) 各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとする。
- 2) 報告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
- 3) 先方政府との説明・協議にかかる議事録は、報告書に添付して提出する。その他、発注者が必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。

## 第6条 「相談窓口」の設置

発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。

別紙：技術提案書にて特に具体的な提案を求める事項

**技術提案書にて特に具体的な提案を求める事項  
(技術提案書の重要な評価部分)**

技術提案書の作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章「1. 技術提案書の作成に係る要件」にて指定した記載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照すること。

No.	提案を求める内容	特記仕様書案での該当条項
1	本調査で焦点を当てる州・地域の特定における評価項目、及び現地コンサルタントの活用方法	第3条 実施方針及び留意事項 (1) 調査対象サイト、(2) 調査対象機関、(3) 調査方針
2	調査内容を踏まえた適切な調査フロー	第4条 調査の内容 (1) 調査内容、(2) 調査項目
3	日本企業の課題・機会分析	第4条 調査の内容 (2) 調査項目 ⑤日本企業の課題・機会分析
4	招へいのテーマ、期間、対象人数及び対象機関、研修実施国(地域)	第4条 調査の内容 (2) 調査項目 ⑨日印関係者招へい

## 第3章 技術提案書作成要領

技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。

### 1. 技術提案書作成に係る要件

本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおりです。

#### (1) 業務の工程

「第2章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。

#### (2) 業務量の目途

機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。

(全体) 7.00人月

(現地渡航回数：延べ9回)

本邦招へいに関する業務人月1.50を含む(本経費は定額計上に含まれる)。なお、上記の業務人月は、国内移動手配に関連しJICAが契約する旅行会社への国内移動旅行の手配依頼書の送付、旅行手配内容の調整・検収、国内機関への報告を含む。

業務従事者構成の検討に当たっては、インド・日本他各国半導体業界・政策、サプライチェーン、インド半導体業界・人材市場・半導体開発研究の知識・専門性を持つ従事者を含めること。

※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。

#### (3) 業務従事予定者の経験、能力

評価対象者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。

【業務主任者：(業務主任者／〇〇) 格付の目安 (3号)】

- 1) 対象国及び類似地域：全世界
- 2) 語学能力：英語

※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。

※ 総合評価落札方式では業務管理グループ(副業務主任)は想定していません。

#### (4) 現地再委託

以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。

インド国内で調査団が訪問しなかった都市の現地調査、ヒアリング等(例：半導体関連分野における企業・研究機関に対するヒアリングの実施、半導体にかかるインフラ整備状況、技術・製品の調査、本邦招へい業務に向けた協議等)

#### (5) 配付資料／公開資料等

##### 1) 配付資料

なし

##### 2) 公開資料

- 「半導体・デジタル産業戦略」(経済産業省、2023年)：  
<https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf>
- 「インド国投資促進プログラムに関する情報収集・確認調査」(JICA、2018年)：  
[https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20180207\\_170898\\_1\\_01.pdf](https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20180207_170898_1_01.pdf)
- 「インド国投資促進プログラムに関する情報収集・確認調査」報告書  
(JICA、2020年)：  
<https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12360228.pdf>
- 「インド国経営幹部育成を基盤とした日印共創ビジネス交流促進プラットフォーム構築プロジェクト(スタートアップ支援)」(JICA、2023年)：  
[https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20230913\\_235410\\_1\\_01.pdf](https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20230913_235410_1_01.pdf)
- 「日印共創イニシアティブ」(経済産業省、2023)：  
<https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230721005/20230721005-a.pdf>

#### (6) 対象国の便宜供与

概要は、以下のとおりです。

	便宜供与内容	
--	--------	--

1	カウンターパートの配置	無
2	通訳の配置	無
3	執務スペース	無
4	家具（机・椅子・棚等）	無
5	事務機器（コピー機等）	無
6	Wi-Fi	無

## （7）安全管理

### 1）治安状況の確認

現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録することとし、現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICA インド事務所、在インド日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、特にサイト視察等に伴う移動や地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制を技術提案書に記載する。なお、以下の対応を行い、必要な経費を計上すること。

- (ア) 契約時点における渡航計画を所定の書式にて事前に発注者に提出するとともに、渡航計画の変更があった場合は直ちに発注者に報告を行うこと。特に現地滞在中における渡航計画の変更に際しては JICA 事務所にも報告すること。
- (イ) インドに渡航・滞在する際には、上記(ア)と併せて、所定の書式に業務従事者別に滞在先、移動手段等を記載し、JICA インド事務所に次週の予定を毎週水曜までに送付すること。なお、書式に変更がある場合は発注者の指示に従うこと。
- (ウ) 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを複数確保し、無線 LAN 接続可能な携帯電話（スマートフォン）に加え、無線インターネット用のデータ通信端末（モバイルルーター、現地にて入手可能）等を用意すること。なお、通信費に計上する備品以外に安全対策として追加で必要な備品がある場合は、安全対策費用として別見積とすること。
- (エ) 現地再委託を行う場合、再委託業者が第三国から調達となった場合においても、緊急事態への対応が適切にとられるよう必要な策を講じた契約を行うこと。
- (オ) 現地での調査実施にあたっては JICA インド事務所、在インド日本大使館（必要に応じて各地域領事館）と逐次情報交換、確認を行うとともに、連絡を密にとること。また、インド国内での安全対策については JICA インド事務所安全班の指示に従い、地方部において現地調査を実施する場合は、調査実施の 2 週間前までに JICA インド事務所に行程案を提出し、承認を得ること。
- (カ) 国内の長距離の陸路移動、特に危険度 2 地域を含む州を通過する長距離の陸路移動は可能な限り避け、飛行機を利用すること。なお、危険度 2 地域を含む州を通過する長距

離の陸路移動を伴う旅行については、在外事務所承認又は安全管理部承認の旅行と位置づけ、渡航不可と判断する場合がありますので、旅行の申請等を前広に行うこと。

- (キ) 本調査の対象となるアッサム州については、①アッサム州ディブルガール市及び同市とグワハティ市を結ぶ主要幹線道路及びその沿線、②シルチャール市、③グワハティ市とメガラヤ州シロン市を結ぶ国道 6 号線のうちアッサム州内の地域において都市間移動及びサイト視察を行う際は日中のみの移動とし、夜間の移動は禁止する。渡航者は、JICA インド事務所に対し、出発地から目的地到着時、目的地出発から出発地に戻った時など、移動が発生するごとに動静報告を行うこと。
- (ク) 現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含め技術提案書に記載すること。

## 2) 行動規制

- (ア) 活動に際しては、現地事情に精通したカウンターパート等を同行させること。
- (イ) 移動にあたっては原則、手配車両を使用し、公共交通機関等は避けること。
- (ウ) 必要に応じ、JICA インド事務所より地元警察等の警護を依頼することがあるため、その際は警察と同行を共にすること。(警護手配に係る費用は発注者が負担する)
- (エ) 都市間及びサイト視察は、基本的に日中のみとし、早朝・夜間の移動は禁止する。

## 3) 通信手段

- (ア) 各都市間の陸路移動、及び各都市と周辺部との陸路移動の際は、現地で利用可能な携帯電話を携行する。
- (イ) 事前にカウンターパート等現地受入機関担当者の氏名及び携帯番号等連絡先を入手し、事務所に報告する。

## 4) 安全な宿舎の手配

在インド日本大使館、JICA インド事務所等からの意見も参考に、渡航の事前に安全な宿舎を確保すること。

## 5) インド地図の扱い

複数国が領有権を主張するカシミール地域及びアルナーチャル・プラデシュ地域（以下、「AP 地域」）を含む地図の取扱いには細心の注意を払い、報告書・成果品等において、インド及びパキスタンについては国全体を示す地図は用いず、関係する地域に限定した地図を作成して使用する。その際、対応が困難もしくは不適當な場合には、発注者と協議のうえ、以下のいずれかの対応とする。限定的な参加者へのプレゼンテーションの場合も同様の対応とする。また、MS Power Point 等によるプレゼンテーション資料においても注意書を省略しない。なお、以下の方針は国際情勢の変化等に鑑み、変更の可能性がある。

- A) 国連地図 を複製使用する。ただし、使用の際に、地図から国連の名前及び地図に付与されている参照番号を削除し、そのうえで、「本地図は国連作成地図を加工した。」または “This map is developed based on UN map” 等と付し、国連の地図を加工していることを明確にする（国連の名前及び地図に付与される参照番号を削除せず使用する場合は、国連の使用許諾を得る必要があるため。詳細は国連地理空間情報局の使用許諾に係るガイドライン を参照）。

- B) 各国が主張する国境と実効支配線を全て表示するとともに、主張に相違がある地域（カシミール地域及び AP 地域）については、配色等でどの国の領土であることを示さない（上記 A）の国連地図と同様の対応）。やむを得ず配色しなければならない場合は、キャプション表示等により、議論のある地域を覆う工夫を加える。
- C) 各国が主張する国境及び実効支配線を点線で表示するとともに、主張に相違がある地域（カシミール地域及び AP 地域）については、配色等でどの国の領土とみなしているかを表さない。

上記 A～C に記載の地図を使用する場合には、以下の免責条項を記載する。地図の出典も合わせて記載する。なお、パワーポイント等においても免責条項を省略せず明記する。

【免責条項】免責：本地図上の表記は図示目的であり、いずれの国及び地域における、法的地位、国境線及びその画定、並びに地理上の名称についても、JICA の見解を示すものではありません。

Disclaimer: This map is only for illustrative purposes and does not imply any opinion of JICA on the legal status of any country or territory, the borderline of any country or territory or its demarcation, or the geographic names.

## 2. 技術提案書作成上の留意点

具体的な記載事項や留意点について以下のとおりです。

### （1）コンサルタント等の法人としての経験、能力

業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等のもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。

記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の「I. 1. プロポーザルに記載されるべき事項」の「（1）コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。

### （2）業務の実施方針等

#### 1) 業務実施の基本方針

#### 2) 業務実施の方法

1) 及び 2) を合わせた記載分量は、20 ページ以下としてください。

#### 3) 作業計画

上記「1）、2）」での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることから、作業計画に作業ごとの投入量（人月）及び担当業務従事者の分野（個人名の記載は不要）を記述して下さい（様式 4-3 の「要員計画」は不要です。なお、様式 4-4 の「業務従事予定者ごとの分担業務内容」は記載ください）。記述に当た

っては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の「I. 1. プロポーザルに記載されるべき事項」の「(2) 業務の実施方針等」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。

#### 4) その他

相手国政府又は JICA (JICA の現地事務所を含む。) からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。

#### (3) 評価対象者の経験・能力等

本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述して下さい。記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2023 年 10 月)」の「I. 1. プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3) 業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。

#### (4) 技術提案書の形式等

技術提案書を提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。

##### 1) 形式

技術提案書は、A 4 判 (縦)、原則として 1 行の文字数を 45 字及び 1 ページの行数については 35 行を上限として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前として下さい。

### 3. 経費積算に係る留意事項

本業務に係る経費を積算するにあたっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン (2023 年 10 月版)」を参照してください。

(URL: <https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html>)

#### (1) 本案件に係る業務量の目途

「第 3 章 技術提案書作成要領」の 1. (2) に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。

#### (2) 別見積

以下の費目については、入札金額には含めず、別見積書として作成し、「8. (2) 提出方法」に基づき提出して下さい。下に該当しない経費については、別見積として認



めず、提案者負担とします。

- ・直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの

(3) 定額計上について

以下の経費については定額で計上を求めるとします。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、技術提案書の提出時の見積には含めないでください。

定額として計上する経費は契約開始後に内容を確定します。精算報告の対象となり、証拠書類に基づいて実費精算します。

	対象とする経費	該当箇所	金額(税抜き)	金額に含まれる範囲	費用項目
1	インド国内で調査団が訪問しなかった都市の現地調査、ヒアリング等	「第2章 特記仕様書 第3条 第3条 調査実施方針及び留意事項 (3) 調査方針	5,000,000 円	調査費一式	再委託
2	本邦招へいにかかる経費	「第2章 特記仕様書 第3条 第3条 調査実施方針及び留意事項 (3) 調査方針	9,182,000 円	直接経費 5,000,000 円 と受入期間の業務人月(半導体分野、4号を想定)1.5人月の報酬 4,182,000 円の合計	報酬 国内業務費

(4) ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務

本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。

別紙：技術提案書評価配点表

技術提案書評価配点表

評 価 項 目	配 点
<b>1. コンサルタント等の法人としての経験・能力</b>	<b>(10)</b>
(1) 類似業務の経験	(6)
(2) 業務実施上のバックアップ体制等	(4)
ア) 各種支援体制 (本邦/現地)	3
イ) ワークライフバランス認定	1
<b>2. 業務の実施方針等</b>	<b>(65)</b>
(1) 業務実施の基本方針、業務実施の方法	35
(2) 作業計画等	30
<b>3. 業務従事予定者の経験・能力</b>	<b>(25)</b>
(1) 業務主任者の経験・能力	(25)
1) 業務主任者の経験・能力: <u>業務主任者/〇〇</u>	(25)
ア) 類似業務等の経験	12
イ) 業務主任者等としての経験	5
ウ) 語学力	5
エ) その他学位、資格等	3